

半導体開発競争の中で世界が求める 日本のパッケージ材料とプロセス技術



菅沼 克昭 Katsuaki Suganuma

北海道大学 電子科学研究所 客員教授
大阪大学 産業科学研究所 フレキシブル3D実装協働研究所 所長/特任教授
技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)3Dパッケージ技術開発部門長

2024年

6月18日(火)

16:00-17:00

電子研棟 1階
会議室

※当講演での配信予定はございません。

当講演は、教育に関するFD講演です。

コロナ禍で訪れた半導体供給網の断裂に続き、米中摩擦、世界各地の紛争勃発で一層の半導体入手の危機感をもたらし、更にはAI技術を支える肝となる半導体技術が各国の発展の大きな柱であることが実感されている。前工程のSi微細化ばかりが問われた半導体進化にはリソグラフィー限界が見え始め、これを支える後工程でチップレット技術を生み出した。これらの激しい動きの中で、我が国では、北海道にRapidusが設置され、同時に全国の半導体製造拠点が整備され始めている。その中で大学が努めるべき開発は多岐に渡り、新たな技術展開には必須の人材育成には大きな役目を担っている。本講演ではその現状を紹介したい。